

【ご案内】半導体実装業界マップをF3Dホームページ掲載

2022年7月29日 F3D(加藤)

F3Dホームページ(トップページ): <https://www.f3d.sanken.osaka-u.ac.jp/>

大阪大学産業科学研究所
フレキシブル3D実装協働研究所

F3Dについて

お問合せ

アクセス

装置案内

三



半導体実装業界マップ
のバナーを作成

< イベント情報 >

2022.06.28 開催
[2022年度第1回先端電子デバイス接着技術研究会会合](#)

2022.06.15 開催
[2022年度第1回WBG実装コンソーシアム会合](#)

2022.03.18 開催
[2021年度 第8回F3D公開講座「F3D、AIセンターのオープンイノベーション 展開総括」](#)

2022.02.25 開催
[2021年度 第7回F3D公開講座「ポスト5G通信を支える基盤技術」](#)

< ニュース >

2022年06月20日
[JPCA展示会に出展](#)

2022年05月17日
[ICEP2022 \(札幌\) で発表しました](#)

2022年04月08日
[化学工業日報「第8回F3D公開講座」F3D講演内容を掲載「信頼性を日本の専売特許に」](#)

2022年04月01日
[接着剤新聞「第7回F3D公開講座」の内容を掲載](#)

[イベント一覧へ](#)

[ニュース一覧へ](#)

< F3Dコンソーシアム内研究会 >

[先端電子デバイス接着技術WG](#)

[先端半導体WMV対策研究WG](#)

[WBG実装コンソーシアム](#)

[半導体実装業界マップ](#)

【ご案内】半導体実装業界マップをF3Dホームページ掲載

大阪大学産業科学研究所

フレキシブル3D実装協働研究所

F3Dについて

お問い合わせ

アクセス

装置案内



半導体実装業界マップ

半導体実装（パワー半導体、先端AI・IoT半導体の実装）に関するビジネス機会創出・拡大のため、F3D実装コンソーシアム参加メンバー（企業や大学等）が有する情報を基に業界マップを作成、今回初めて世の中に情報発信するものである。製品化企業等一覧及び製品等詳細（製品・技術名、カテゴリー、特徴・アピール点）で構成される。企業名を選択するとリンクが開き、製品やその技術情報等を見ることが出来る。

本業界マップの取扱いについては、改編、改ざん、販売を禁止する。問合せ先は以下の通り。

F3D研究所 加藤豊 TEL:06-6879-4295 e-mail: katoyu@sanken.osaka-u.ac.jp

[【ご案内】半導体実装業界マップ](#)

[【F3DHP掲載】半導体実装業界マップ](#)

- ▽ 先端電子デバイス接着技術WG
- ▽ 先端半導体WMV対策研究WG
- ▽ WBG実装コンソーシアム
- ▽ 半導体実装業界マップ
- ▽ F3D実装コンソーシアム関連企業技術紹介
- ▽ 登録企業情報一覧
- ▽ 各種書類



半導体実装業界マップの説明及びマップ中身をご確認いただけます。マップ（製品等詳細）の企業名をクリックするとその製品情報（詳細）を確認することが可能です。ご活用いただければと思います。

【業界マップの取扱いについて】

・改編、改ざん、販売を禁止する

・問合せ先:F3D研究所 加藤豊 TEL:06-6879-4295 e-mail:katoyu@sanken.osaka-u.ac.jp